

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **ASMPPT LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### **二零二四年全年業績新聞稿**

有關 ASMPPT Limited 及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止全年業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命  
董事  
黃梓達

香港，二零二五年二月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)



## ASMPPT 公布二零二四年全年業績

### 先進封裝繼續受惠於人工智能的採用 TCB 新增訂單總額及銷售收入創新高

#### 集團業績概覽

##### 集團財務概要: 二零二四年第四季度

- \* 銷售收入為港幣 34.0 億元(4.38 億美元), 按年持平, 按季則+1.8%
- \* 新增訂單總額為港幣 32.6 億元(4.19 億美元), 按年+19.2%, 按季亦+2.8%
- \* 毛利率為 37.2%, 按年-508 點子, 按季亦-379 點子
- \* 經營利潤為港幣 510 萬元, 按年-97.3%, 按季亦-97.1%
- \* 盈利為港幣 420 萬元, 按年-94.4%, 按季亦-82.3%; 經調整盈利為港幣 8,190 萬元, 按年+7.2%, 按季亦+177.5%
- \* 每股基本盈利為港幣 0.01 元, 按年-94.4%, 按季亦-83.3%; 經調整每股基本盈利為港幣 0.20 元, 按年+11.1%, 按季亦+150.0%

##### 集團財務概要:二零二四年

- \* 銷售收入為港幣 132.3 億元(16.9 億美元), 按年-10.0%
- \* 新增訂單總額為港幣 127.5 億元(16.3 億美元), 按年+4.0%
- \* 毛利率為 40.0%, 按年+70 點子
- \* 經營利潤為港幣 5.58 億元, 按年-49.4%
- \* 盈利為港幣 3.42 億元, 按年-51.9%; 經調整盈利為港幣 4.26 億元, 按年-42.8%
- \* 每股基本盈利為港幣 0.83 元, 按年-52.0%; 經調整每股基本盈利為港幣 1.04 元, 按年-42.9%
- \* 於二零二四年十二月三十一日, 未完成訂單總額為港幣 60.5 億元(7.79 億美元)
- \* 二零二四年全年合計每股派息(包括特別股息)為港幣 0.67 元

##### 二零二五年第一季度銷售收入預測

- \* 將介乎 3.7 億美元至 4.3 億美元之間, 以其中位數計按年持平, 按季則-9%

詳盡業績公告及投資者簡報可見於

<https://www.asmppt.com/en/investor-relations/financial-information/>

有關上述經調整盈利及經調整每股基本盈利之詳情, 請參閱集團二零二四年第四季度業績公告「香港財務報告準則計量對非香港財務報告準則計量之對賬」一節。

(二零二五年二月二十六日，香港訊) — **ASMPT Limited** (「ASMPT」/「集團」/「公司」) (股份代號：0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬體和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之業績。集團的先進封裝 (「AP」) 解決方案發展勢頭強勁，其中熱壓焊接 (「TCB」) 的年度銷售收入及新增訂單總額均創新高。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「我們渡過了充滿挑戰的二零二四年，在人工智能及高性能計算的推動下，先進封裝解決方案有所增長，但多個終端市場應用領域卻出現持續疲軟。憑藉我們獨特及多元化的產品組合、持續的技術領導地位，以及我們對策略性研發及基礎設施投資的堅定承諾，讓ASMPT能夠充分把握機遇，推動公司實現新的里程碑。」

## 集團二零二四年摘要

在人工智能及高性能計算 (「HPC」) 的增長推動下，邏輯及記憶體封裝應用的需求表現強勁。集團的先進封裝解決方案繼續成為人工智能加速應用下的主要受惠者，銷售收入按年增長 23%。另一方面，由於消費意欲疲弱導致電子產品的需求低迷，加上汽車及工業終端市場疲軟，因此非人工智能相關半導體的復蘇較預期緩慢。這影響了集團半導體解決方案分部的主流產品及表面貼裝技術解決方案分部的業務。

- 全年銷售收入為港幣 132.3 億元 (16.9 億美元)，按年下降 10.0%；半導體解決方案分部錄得銷售收入增長，而表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入則下降。
- 集團新增訂單總額按年增長 4.0% 至港幣 127.5 億元 (16.3 億美元)，半導體解決方案分部的新增訂單總額錄得增長，主要是受先進封裝所推動，但部分被表面貼裝技術解決方案分部所抵銷。
- 集團的未完成訂單總額於年底達港幣 60.5 億元 (7.79 億美元)，訂單對付運比率為 0.96。
- 集團毛利率按年上升 70 點子至 40.0%，主要是受半導體解決方案分部所推動，但部分被表面貼裝技術解決方案分部的下跌所抵銷。
- 經調整盈利按年下降 42.8% 至港幣 4.26 億元。
- 資產負債表保持穩健，錄得強勁的現金及銀行存款港幣 51.0 億元，淨現金為港幣 24.2 億元。
- 董事會建議向股東派發末期股息每股港幣 0.07 元及特別股息每股港幣 0.25 元，於二零二四年度全年合計每股派息為港幣 0.67 元。

集團的先進封裝解決方案仍然是亮點，受生成式人工智能及高性能計算應用的高速增長所推動，市場對多個先進封裝解決方案的需求強勁。先進封裝解決方案的銷售收入按年增長 23% 至約 5.05 億美元，其對集團總銷售收入貢獻由 22% 按年增長至二零二四年的近 30%。集團預計先進封裝解決方案的總潛在市場將從二零二四年的 17.8 億美元逐步擴大至二零二九年的 40.4 億美元，年均複合增長率約為 18%。

以下是先進封裝的一些亮點:

**TCB**：集團的 TCB 解決方案進一步獲得多名客戶及主要人工智能企業的青睞，實現年度銷售收入及新增訂單總金額創新高。邏輯及記憶體應用推動訂單創新高，集團的先進封裝新增訂單總額按年強勁增長，主要是受 TCB 新增訂單總額顯著增長所帶動。

- **邏輯應用**：集團從其領先晶圓代工客戶及該客戶的外判半導體裝嵌及測試（「OSAT」）合作夥伴獲得可觀的 TCB 訂單，並作為他們的唯一供應商。集團亦已交付大批量 TCB 工具，並預期二零二五年將繼續保持強勁的訂單勢頭。此外，集團與領先晶圓代工客戶共同開發用於超微間距晶片到晶圓（「C2W」）邏輯應用的新一代免助焊劑去氧化（「AOR免助焊劑」）TCB工藝的項目亦進展順利。
- **高頻寬記憶體應用**：集團獲得來自主要高頻寬記憶體企業的可觀的 TCB 訂單，尤其在二零二四年下半年。集團於二零二四年第四季度贏得一家領先高頻寬記憶體製造商的批量 TCB 訂單，以支持其 HBM3e 12 層批量生產需求增長，這標誌著集團的一個重要里程碑。整體高頻寬記憶體的突破帶動 TCB 整體新增訂單總額按年大幅增長。最近，集團獲得來自另一家全球高頻寬記憶體企業的幾款工具的初始訂單。集團亦正與這些高頻寬記憶體企業就重複訂單展開深入商議。

集團預期TCB的總潛在市場將快速擴張，預計從二零二四年的3.03億美元增長至二零二七年約10億美元，年均複合增長率超過45%，目標是佔據35%至40%的TCB市場佔有率。

**混合式焊接（「HB」）**：集團於二零二四年第三季度向一家邏輯客戶交付首部混合式焊接工具，這標誌著集團的一個重要里程碑。集團亦獲得兩部用於高頻寬記憶體應用的新一代混合式焊接工具的首次訂單，這些工具計劃並於二零二五年中進行交付。憑藉這些新一代混合式焊接工具，集團有信心在未來季度獲得更多訂單，使其處於有利位置以把握未來大批量生產（「HVM」）的需求增長。

**覆晶（「FC」）高精確固晶**：集團高精確覆晶焊接工具用於現時領先晶圓代工廠及其外判半導體裝嵌及測試合作夥伴的晶片到晶圓應用，而這些應用目前採用了覆晶回流焊接（「MR」）工藝。由於預期覆晶回流焊接在短期內繼續將是這些客戶在晶片到晶圓應用方面的工藝標準（「POR」），集團預計二零二五年其覆晶工具的訂單將進一步增加。

**光子**：由於受主要人工智能企業對更高頻寬及更快傳輸速度的光學收發器需求所推動，集團的領先市場光子解決方案的全年訂單勢頭強勁。

**共同封裝光學（「CPO」）**：集團的矽光子解決方案憑藉其領先的超高精確度焊接解決方案在共同封裝光學裝嵌及高端光通信相關應用中獲得重大優勢。這些技術優勢讓集團領先同儕。儘管共同封裝光學市場仍處於早期發展階段，但集團作為光子領導者的地位，並與全球領先的共同封裝光學企業積極合作，使其在未來佔據矽光子解決方案市場佔有率方面處於有利地位。

**系統封裝（「SiP」）**：表面貼裝技術解決方案分部的系統封裝解決方案於上半年贏得了主要來自全球領先高端智能手機企業對射頻模組及可穿戴設備的應用的強勁訂單，並一直在新一代系統封裝工具方面與多個客戶合作，這些工具在人工智能及伺服器相關應用穩步發展，並已付運予領先晶圓代工客戶及外判半導體裝嵌及測試企業。

按應用領域劃分，汽車終端市場應用在二零二四年集團總銷售收入中佔比最高，約20%或約3.40億美元。即使市場疲弱，集團的全面汽車解決方案（包括電動化、傳感器技術、顯示屏及高速數據傳輸）仍繼續帶來強勁貢獻，強勁的銷售收入來自半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部。集團預計汽車終端市場應用的總潛在市場將從二零二四年的約13億美元增長至二零二九年的21億美元，年均複合增長率約為11%。

## 集團二零二四年第四季度概要

- 集團的銷售收入為港幣 34.0 億元（4.38 億美元），高於先前發布的銷售收入預測的中位數，按季微升 1.8%，按年則持平。
- 集團的新增訂單總額為港幣 32.6 億元（4.19 億美元），按季增長 2.8%，按年亦增長 19.2%，主要由於半導體解決方案分部的先進封裝新增訂單總額增長強勁，但部分被表面貼裝技術解決方案分部的跌幅所抵銷。
- 毛利率為 37.2%，按季下跌 379 點子，按年亦下跌 508 點子。
- 集團的經調整盈利為港幣 8,190 萬元，由於外幣匯兌收益，按季增長 177.5%，按年亦增長 7.2%。

## 投資未來

集團繼續優先投資於具有關鍵策略重要性的領域，例如先進封裝的研發和基礎設施，以確保能把握未來的機遇並在各種解決方案中保持領先地位。集團計劃將於二零二五年投資約港幣 3.5 億元以支持這些優先投資。集團將繼續嚴格控制資本性開支投資，並在二零二五年底將 TCB 產能提高一倍。

## 前景

隨著二零二五年的展開，集團在人工智能及高性能計算應用方面的 TCB 解決方案的強勁勢頭預計將繼續推動整體先進封裝銷售收入的增長。因此，先進封裝在集團總銷售收入的佔比將更高。集團 TCB 解決方案在邏輯和記憶體應用方面的重大躍進將進一步鞏固了集團作為 TCB 市場領導者的地位。

短期內，集團先進封裝銷售收入的增長將因主流市場，特別是汽車及工業的持續疲軟而被抵銷。因此，集團預計二零二五年第一季度的銷售收入將介乎 3.7 億美元至 4.3 億美元之間，以其中位數計按年持平，按季則下降 9%。

### 關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT 是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬體及軟件解決方案供應商。ASMPT 總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及 SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及 LED(顯示板)。ASMPT 與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。ASMPT 也是 [半導體氣候聯盟](#) 的創始成員之一。

ASMPT 在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生科技指數、恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港 35 指數之成份股。詳細資訊請查閱 ASMPT 網頁 [www.asmpt.com](http://www.asmpt.com)。

### 前瞻性聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻性聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，多種因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻性聲明，而 ASMPT 不會承擔任何義務公開地更新或修訂任何前瞻性聲明。除下文另有提及外，本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢：

林詒源 (Lim Ee Guan)

企業傳訊總監

電話：+65 6450 1445

電郵：[eg.lim@asmpt.com](mailto:eg.lim@asmpt.com)

代表 ASMPT：

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 / 梁頌欣

電話：+852 2864 4812 / 2864 4862

傳真：+852 2527 1196

電郵：[mandy.go@sprg.com.hk](mailto:mandy.go@sprg.com.hk) / [vivienne.leung@sprg.com.hk](mailto:vivienne.leung@sprg.com.hk)